

信頼性試験結果

製品名 : S-93A66BD0A-T8TxU3

搭載パッケージ : 8-Pin TSSOP

No.	試験名	試験条件	時間	r/n	故障判定基準
1	高温動作	Ta=125 °C, V = Vopr max.	2000 h	0/22	製品規格を満足すること
2	高温高湿バイアス #1	Ta=85 °C, RH=85 % V = Vopr max.	2000 h	0/22	製品規格を満足すること
3	プレッシャクッカ・バイアス #1	Ta=130 °C RH=85 % P=2.3×10 ⁵ Pa V = Vopr max.	96 h	0/22	製品規格を満足すること
4	高温保存	Ta=150 °C	2000 h	0/22	製品規格を満足すること
5	低温保存	Ta=-65 °C	2000 h	0/22	製品規格を満足すること
6	書き換えサイクル-1	Ta=85 °C, V= Vopr max.	1× 10 ⁶ cycles	0/22	製品規格を満足すること
7	書き換えサイクル-2	Ta=105 °C, V= Vopr max.	8× 10 ⁵ cycles	0/22	製品規格を満足すること
8	書き換えサイクル-3	Ta=125 °C, V= Vopr max.	5× 10 ⁵ cycles	0/22	製品規格を満足すること
9	温度サイクル (気相) #1	Ta=150 °C ⇔ -65 °C, 各 15 分	1000 cycles	0/22	製品規格を満足すること
10	はんだ耐熱性 1 (リフロー) #2	T=260 °C, 10s	3 回	0/22	製品規格を満足すること 外観上、異常がなきこと
11	はんだ耐熱性 2 (はんだゴテ) #2	T=380 °C, 5s (はんだコテ先温度) 対象 : リード部	2 回	0/22	製品規格を満足すること 外観上、異常がなきこと
12	はんだ耐熱性 3(フロー) #2	T=260 °C, 10s	1 回	0/22	製品規格を満足すること 外観上、異常がなきこと
13	はんだ付け性 #3	T=245 °C はんだ材 : Sn-3.0Ag-0.5Cu	5 s	0/11	ゼロクロスタイムが 3 秒以内 であること 半田浸漬部分の 95%以上が 半田で覆われること
14	ウイスカ 1 (室温保存)	Ta=30 °C, RH=60%	4000h	0/6	ウイスカサイズが 40 μm 以下 であること
15	ウイスカ 2 (温度サイクル)	Ta=85 °C ⇔ -40 °C	1500 cycles	0/6	ウイスカサイズが 45 μm 以下 であること
16	ウイスカ 3 (高温高湿保存)	Ta=55 °C, RH=85 %	4000h	0/6	ウイスカサイズが 40 μm 以下 であること
17	はんだ接合信頼性 (せん断強度) #3	Ta=125 °C ⇔ -40 °C はんだ材 : Sn-3.0Ag-0.5Cu	2000 cycles	0/22	初期強度値の 50%以上の 強度を維持すること
18	リード引っ張り強度	引張力 : 1.0N	30 s	0/11	リードが脱落しないこと
19	リード曲げ強度	引張力 : 0.5N 45 度折り曲げ	2 回	0/11	リードが脱落しないこと
20	静電耐圧1(HBM)	V=±2000 V, C=100 pF, R=1.5 kΩ V _{CC} 基準, GND 基準	5 回	0/5	製品規格を満足すること
21	静電耐圧2(CDM)	V=±500 V 帯電, 接地放電	1 回	0/5	製品規格を満足すること

22	ラッチアップ強度1 (パルス電流注入法)	$\pm 100 \text{ mA}$, $V = V_{opr \text{ max.}}$	1回	0/5	ラッチアップしないこと
23	ラッチアップ強度2 (電源過電圧法)	$V = V_{opr \text{ max.}}$ から規定の過電圧	1回	0/5	ラッチアップしないこと

注) $V_{opr \text{ max.}}$ =最大動作電圧

#1,2,3 : 前処理を実施後、シリーズに試験を実施する。

前 処 理 (#1)		
高温保存	吸湿処理	熱 処 理
Ta=125 °C t=24 h	Ta=85 °C RH=85 % t=168 h	リフロー3回 T=260 °C t=10 s

前 処 理 (#2)		
高温保存	吸湿処理	熱処理
Ta=125 °C t=24 h	Ta=85 °C RH=85% t=168 h	—

前 処 理 (#3)		
高温保存	吸湿処理	熱処理
—	Ta=105 °C RH=100% t=8 h	—